

# 参加募集 第53回エンジニアリングセラミックスセミナー

## 「セラミックスの信頼性向上に貢献するシミュレーション技術」

産業競争力の維持と強化のためにデジタルトランスフォーメーションが強く推進されていますが、セラミックスにおいても製品開発を加速させ、その信頼性を高めるためには、計算機によるシミュレーション技術がますます重要になっております。本セミナーでは、粉体や焼結などのプロセスに加えて破壊のシミュレーションに携わられている先生方をお招きして、研究開発の最前線と今後の展望をご紹介していただき、シミュレーション技術の有用性や課題について理解を深める機会とします。

主催：日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

協賛：応用物理学会，日本化学会，日本金属学会，日本ファインセラミックス協会，耐火物技術協会，粉体工学会，粉体粉末冶金協会（予定）

開催日時：2022年11月4日（金） 13：30～

場所：東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 武田ホール（東京都文京区弥生2-11-16）

URL: [https://nanotech.net.t.u-tokyo.ac.jp/about\\_cr.html#access](https://nanotech.net.t.u-tokyo.ac.jp/about_cr.html#access)

東京メトロ千代田線「根津駅」1番出口から徒歩5分，東京メトロ南北線「東大前駅」1番出口から徒歩10分

（今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によってオンライン方式に変更する可能性があります。）

定員：100名

参加費：会員13,000円（特別会員，協賛学協会員含む），学生会員6,000円，非会員15,000円  
（申込時入会は会員扱い）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（[http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index\\_j.html](http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html)）の申込フォームよりお申し込みください。参加費は11/1までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：公益社団法人日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

Email : [encera \[at\] cersj.org](mailto:encera[at]cersj.org)（[at]部分を@に変えて下さい。）

振込先：三菱UFJ銀行千里中央支店（普）0073211

（公社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義  
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

【プログラム（講演の順番を当初予定から変更しております。）】

13:30～13:35 開会挨拶

エンジニアリングセラミックス部会 部会長 TOTO(株) 清原正勝

13:35～14:15 「セラミックス遮熱コーティングの非弾性変形挙動と熱疲労寿命評価法について」

東京理科大学 荒井正行

14:15～14:55 「粉体成形プロセスのシミュレーションベースデジタルツインに関する基礎研究」

東京大学 酒井幹夫

14:55～15:35 「マクロスケールとメゾスケールでの焼結解析へのアプローチ」

九州大学 品川一成

休憩

15:55～16:35 「シミュレーションによるセラミックスの液相焼結解析」

(株)村田製作所 松本修次

16:35～17:15 「CMC開発へのシミュレーション技術の新展開：デジタルマテリアルツイン」

一橋大学 七丈直弘

17:15 閉会挨拶

エンジニアリングセラミックス部会 副部会長 (一財)ファインセラミックスセンター 北岡諭